

	A室	B室	C室
9:15	<p>[2A1] JEITA 低融点鉛フリーはんだプロジェクト (座長) 竹本 正(大阪大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> Sn-8Zn-3BiはんだによるSMDのリフトオフと接合信頼性 中村喜一(TDK) Sn-8Zn-3Biはんだによる半導体部品(LQFP, CSP)の接合信頼性 気賀智也(ソニー), 伊藤卓夫(日本テキサス・インスツルメンツ), 亀山工次郎(三洋電機), 西村朝雄(日立製作所), 坂口茂樹(松下電器産業) ICのリフトオフ現象解明とその対策 高橋邦明(東芝) 端子・はんだ間には離現象解明とその対策 豊田良孝(千住金属工業) ランドはく離防止に関する一考察 渡辺浩幸(TDK) 	<p>[2B1] マイクロマシニング (座長) 小倉 洋(松下電器産業)</p> <ol style="list-style-type: none"> Siマイクロマシニング技術を用いたマルチチップ一括コンタクトシステム 河野電治, 金丸昌敏, 宮武俊雄, 伴 直人, 長谷部昭男(日立製作所) LiGAプロセスで製作したマイクロコンタクトプローブ 羽賀 剛, 岡田一範, 平田嘉裕(住友電気工業), 山下創一, 早坂伸夫(東芝) 尖鋭突起加工したダイヤモンド電子エミッタの開発 西林良樹, 安藤 豊, 古田 寛, 小橋宏司(ファインセラミックスセンター), 日黒貴一, 今井貴浩, 田遠伸好(住友電気工業), 平尾 孝, 尾浦憲治郎(大阪大学) UV厚膜レジストを用いた高密度実装用マイクロコネクタの製作と特性評価 海野敏典(立命館大学), 鳥山寿之(新エネルギー産業技術総合開発機構), 杉山 進(立命館大学) リードフレームの微細化に対応した電鍍法による低熱膨張Ni-Fe合金膜の作製 永山富男, 水谷 泰, 中村俊博, 篠原長政(京都市工業試験場) 	<p>[2C1] 実装材料・プロセス (座長) 齋藤雅之(東芝)</p> <ol style="list-style-type: none"> フラックスレスハンダ実装工法 森 俊裕, 山内 朗(東レエンジニアリング), 佐上洋祐(デクスター) 樹脂基板におけるAuワイヤのS字状曲がりに関する検討 安原和彦, 板橋一光(田中電子工業) ACF接続部の導電粒子配合設計 山田 毅, 西田秀行, 小林繁隆(日本アイ・ピー・エム) ベアIC SMD混載基板におけるプラズマ洗浄の検討 鈴木直樹(松下電器産業), 瀧口正敏, 藤田裕一(松下通信工業), 小倉 洋, 富田和之(松下電器産業) 次世代バンプレス接合のためのCMP-Cu薄膜常温直接接合 重藤暁津, 細田奈緒絵, 伊藤寿浩, 須賀唯知(東京大学)
10:45	<p>[2A2] 鉛フリーはんだ 表面処理 (座長) 藤原 裕(大阪市立工業研究所)</p> <ol style="list-style-type: none"> 電位パルス電解法によるAu-Sn合金めっき 粟津亮二, 篠原直行, 新井 進, 金子紀男(信州大学), 倉科 匡(大和電機工業), 若林信一(新光電気工業) シアンフリーAu-Sn合金めっき 岡田 隆, 内田 衛(石原薬品) 無電解Ni-P合金めっき / 置換Auめっきのはんだ接合強度に及ぼすNi-P合金皮膜中のW共析の影響 岩崎保紀, 赤松謙祐, 縄舟秀美, 水本省三(甲南大学) フリップチップBGAのPbフリー化における無電解Niめっきバリアメタルの検討 西山知宏, 馬場幹夫, 田子雅基, 銅谷明裕(日本電気) プリント配線板の各種表面処理とはんだ付け性 村田俊也, 若松克茂, 内藤 薫, 中岸 豊(奥野製薬工業), 川嶋和之, 恒益喜美男, 田中靖則(日本電気) 	<p>[2B2] モジュール実装 (座長) 天明浩之(日立製作所)</p> <ol style="list-style-type: none"> インサート成型リードフレームを用いたトランスファモールド型光送受信モジュール 岡田 毅, 中西裕美, 平山憲司, 山口 章, 工原美樹(住友電気工業) 部品内蔵モジュールの層間接続技術の開発 小松慎五, 中谷誠一, 菅谷康博, 朝日俊行, 山本義之(松下電器産業) 小型軽量のマルチ・チップ・パッケージの開発 明石裕二, 高島 晃(富士通) MID(立体回路基板)へのフリップチップ実装技術の開発 八木能彦, 吉野道朗, 中村浩二郎(松下電器産業), 原園文一(松下通信工業) ACFを用いた複数チップ狭隣接実装技術の開発 八木優治(松下電子部品), 勝又雅昭, 柏木隆文(松下電子部品) 	<p>[2C2] 実装材料・プロセス (座長) 橋本 薫(富士通研究所)</p> <ol style="list-style-type: none"> リペア可能なベアチップ実装用接着剤とこれを用いた実装技術 徳平英士, 八木友久, 今泉延弘, 伊達仁昭, 堀越英二(富士通研究所) フリップチップLSI実装におけるリペア可能アンダーフィル樹脂の開発 久保雅洋, 杉山一郎, 樺沢俊也, 北城 栄, 松井孝二(日本電気) 金属錯体及び金属超微粒子ペーストによる導電パターン形成 中許昌美(大阪市立工業研究所) 微細配線に対応する銅ナノ粒子分散ポリイミド樹脂の作製 池田慎吾, 赤松謙祐, 縄舟秀美, 水本省三(甲南大学), 出来成人(神戸大学) 液晶ポリマフィリムの高密度実装への応用 福武素直, 大幡裕之, 栗原康浩, 杉岡幹昌(ジャパングアテックス)
12:20	昼休み		
13:20	<p>[2A3] 鉛フリーはんだ Sn-Zn系 (座長) 縄舟秀美(甲南大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> Sn-Zn系フローはんだ付け技術 忠内仁弘, 小松 出, 立石浩史, 手島光一(東芝) Sn-Zn系鉛フリーはんだ材料の開発 北嶋雅之, 竹居成和, 庄野忠昭(富士通), 野口道子, 橋本 薫(富士通研究所) Sn-Zn系鉛フリーはんだと鉛フリーめっき部品の接合信頼性評価 小松 出, 立石浩史, 小川英紀, 山本展大, 高島幸夫(東芝) Sn-Zn-Bi系はんだとFe系合金との接続信頼性 金 迎竜, 黄 致元, 金 権鉄, 菅沼克昭(大阪大学) Sn-Zn系鉛フリーはんだとCu電極との接合界面反応層の成長挙動と高温安定性 金 権鉄, 金 迎竜, 黄 致元, 許 碩桓, 菅沼克昭, 中嶋英雄(大阪大学) Sn-Zn系はんだによるブリッジ形成問題の解決方法 立石浩史, 小松 出, 山本展大, 石井憲弘, 小川英紀, 田中秀典(東芝) 	<p>[2B3] 3次元実装 (座長) 畑田賢造(アトムニクス研究所)</p> <ol style="list-style-type: none"> チップレベル3次元実装技術 真篠直寛, 村山 啓, 栗原 孝, 清水満晴, 東 光敏(新光電気工業) 3次元実装におけるウェハ薄型化 / 裏面加工技術 春原昌宏, 藤井知徳, 星野雅孝, 米村 均, 高橋健司(超先端電子技術開発機構) 3次元実装BGAタイプモジュールの開発 松浦哲也, 橋本知明, 笠谷泰司(三菱電機), 一政忠志(KDL) 三次元積層LSIにおける微細間隙封止樹脂の最適化 安藤達也, 富田至洋, 森藤忠洋, 佐藤知稔, 田中直敬, 高橋健司(超先端電子技術開発機構) 微細ピッチ三次元積層構造における非破壊解析技術の検証 藤井知徳, 富田至洋, 安藤達也, 森藤忠洋, 高橋健司(超先端電子技術開発機構) 多層三次元実装封止技術 ホレイシオ・クイノネス, アレック・パビアズ, カルロス・ポウラス(アシムテック), 中村義一(未来実装研究所) 	<p>[2C3] 評価・シミュレーション (座長) 江森雄二(沖電気工業)</p> <ol style="list-style-type: none"> BGAパッケージのアセンブリプロセス解析 金子正秀(横浜国立大学), 酒井秀久(横浜国立大学 / 富士通), 于 強, 白鳥正樹(横浜国立大学) BGAはんだ接合部の統計的疲労強度試験法 効屋貴司(横浜国立大学), 廣畑賢治(横浜国立大学 / 東芝), 向井 稔(東芝), 于強, 白鳥正樹(横浜国立大学) 基板ひずみによるBGAはんだ接合部の落下衝撃強度評価 矢口昭弘, 山田宗博(日立製作所) FBGAパッケージの積層構造および接合材料と信頼性に関する研究 土橋健一, 千野 満(ミスズ工業), 宮島賢治(東芝), 辺見信彦(信州大学) 機械的疲労試験によるCSP/PWB接合部の疲労寿命評価 荻谷義治, 森智智雄(芝浦工業大学), 田中靖則(日本電気), 大塚正久(芝浦工業大学) 落下衝撃時の基板のたわみ変形とはんだ接合部の衝撃信頼性評価 池田真哉, 于 強, 白鳥正樹, 菊池宏信(横浜国立大学)
15:08	<p>[2A4] 鉛フリーはんだ めっき技術 (座長) 近藤和夫(岡山大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 有機スルホン酸浴からの銅-銀合金の電析及び皮膜特性 今藤 桂, 若林信一(新光電気工業), 金子紀男(信州大学) スルホコハク酸浴からのスズ-亜鉛共合金の電析および皮膜特性 中谷敏雄, 赤松謙祐, 縄舟秀美, 水本省三(甲南大学), 内田 衛(石原薬品), 小幡恵吾(大和化成研究所) スズおよびスズ-銀合金めっき皮膜のスズ-銀はんだ接合特性 藤原 裕, 榎本英彦(大阪市立工業研究所), 長尾敏光, 星加 洋(関西大学) メタンスルホン酸浴からのSn-Bi合金 酒井豊明, 篠原直行, 新井 進, 金子紀男(信州大学) 電気めっき法による硫酸浴からのSn-Cuはんだパンプの作製 関 雅子, 金子紀男, 新井 進, 篠原直行(信州大学), 若林信一(新光電気工業) 電気めっき法によるフリップチップ接合用Sn-Agはんだパンプの作製 赤塚英城, 新井 進, 金子紀男, 篠原直行(信州大学) 	<p>[2B4] パッケージ化技術 (座長) 嶋田勇三(日本電気)</p> <ol style="list-style-type: none"> 封止樹脂プリフォームによるフラックスレスフリップチップ接合技術開発 畑中康道, 多田和弘, 藤岡弘文(三菱電機) 次世代チップキャリア用ビルドアップ配線板に要求される絶縁体特性の考察 小林 馨, 山中公博, 森 裕幸, 塚田 裕(日本アイ・ピー・エム) LCDドライバー実装における接続技術 桜井和徳(セイコーエプソン) Auめっきテープ基板を用いた超音波フリップチップ接合特性の検討 小泉正博, 梶原良一(日立製作所), 岡部則夫(日立電線), 西村朝雄(日立製作所) 2チップCOF技術の開発 豊沢健司, 鈴木岳洋, 千川保憲, 福田和彦(シャープ), 藤田正信(シャープタカヤ電子工業) アンテナ・フィルタ内蔵60GHz帯受信フロントエンドIC 小倉 洋, 浦部丈晴(松下電器産業), 寒川 潮, 藤田 卓, 高橋和晃(松下技研) 	<p>[2C4] 評価シミュレーション (座長) 高原秀行(日本電信電話)</p> <ol style="list-style-type: none"> 高速高周波デバイス実装におけるグラウンド分割問題とその解決方法 井上博文, 藤村雄己(日本電気) 伝送線路におけるTEM波 / 擬似TEM波に対する考察 上田千寿(データプローブ), 大塚寛治(明星大学), 宇佐美 保, 大館康彦(東京大学) LSI搭載プリント板のI/O出力動作モードにおける不要輻射に関する考察 芳賀 知, 中野 健, 須藤俊夫(超先端電子技術開発機構) 多ピンBGAパッケージの電気特性評価 神 隆則, 山方寛子, 加藤克人, 三浦正幸, 池永守彦(東芝) 樹脂基板に向けたインダクタ/キャパシタの高周波特性 島田 靖, 大塚和久, 平田善毅(日立化成工業) ウェハレベルCSPにおける伝送特性及び受動部品の内蔵化技術 西角沙耶香, 上 芳夫(電気通信大学), 青木由隆(IEPテクノロジーズ)
15:12			
17:00			